

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称	百嘉基金 百年保险 宝盈基金 贝莱德 博道基金 博时基金 财通证券 财通资管 长安基金 长城基金 长城证券 长江证券 大家资产 德邦基金 东北证券 东方基金 东吴基金 东吴证券 东兴基金 工银理财 光大保德信 广东钜洲 广东正圆 广发证券 国海证券 国华兴益 国金基金 国君资管 国联安基金 国联民生 国盛证券 国寿安保 国寿养老 国泰基金 国信证券 海南鸿盛 宏利基金 华宝基金 华创证券 华福证券 华富基金 华金证券 华美国际 华泰证券 华泰资产 汇安基金 汇丰晋信 汇丰前海 汇添富 惠升基金 嘉实基金 建信基金 金信基金 金鹰基金 麦高证券 民生加银 民生通惠 南土资产 诺安基金 盘京投资 鹏万投资 鹏扬基金 平安基金 平安证券 前海百创 前海方位 前海开源 全天候 泉果基金 人保香港 人保养老 融通基金 善思投资 上海常春藤 上海晨燕 上海利幄 上海盘京 上海朴信 上海尚雅 上海潼骁 上海循理 深圳明诚 深圳清水源 太平基金 太平资产 泰信基金 天弘基金 溪牛资产 新华资产 兴业基金 兴业证券 易方达 易米基金 银河基金 永赢基金 圆石投资 浙商资管 中庚基金 中国人寿 中金资管 中欧瑞博 中泰证券 中信保城 中银基金 中邮基金 中邮证券 朱雀基金

	国金证券 君弘投资 上银基金
会议时间	2025 年 04 月 28 日—06 月 05 日
会议地点	线上会议；公司会议室
上市公司 接待人员 姓名	董事长、总经理：周正宇 董事会秘书：XIE MEI QIN 证券事务代表：程奔驰
投资者关 系活动主 要内容介 绍	经营情况简介 2025 年第一季度，公司实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 62.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,144.97 万元，同比增长 385.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,861.61 万元，同比增长 606.03%。 报告期内，公司积极拥抱端侧产品 AI 化的进程，持续投入技术研发并迭代新品，积极开拓新市场和新客户，端侧 AI 处理器芯片出货量不断攀升，销售收入保持快速增长；低延迟高品质无线音频产品加速放量，销售额持续上扬；蓝牙音箱 SoC 芯片系列持续加大在头部音频品牌的渗透力度，不断深化公司与客户合作的广度和深度，产品不断迭代和放量。整体看，公司产品销售表现亮眼，助力公司营收大幅增长，随着公司产品结构和客户结构持续优化，毛利润和净利润实现快速增长。 Q1：目前经营情况如何？ 答：从公司主要产品线所在的市场情况分析，在蓝牙音箱市场，公司持续提升在国际一线品牌客户的渗透率；在低延迟高品质无线音频市场，持续受益于下游无线麦克风、电竞外设、家庭影院音响系统等多种产品不断加速的无线化进程，销售收入保持高增长；在端侧 AI 处理器领域，公司产品出货量不断攀升，销售收入保持快速增长。 Q2：公司端侧 AI 新产品的竞争优势和差异化特点是什么？ 答：公司新产品创新性地采用了 CPU+DSP+NPU 三核异构架构设计，其中的 AI 加速引擎-NPU 是基于模数混合 SRAM 存内计算技术打造，由此带来的超

	高能效比是公司区别于市面友商传统冯·诺依曼架构产品的显著差异点。选择存内计算技术路线的初衷,是公司对于端侧 AI 技术趋势的深入研判思考,我们认为,端侧 AI 产品海量的机会存在于对专用场景下专用模型的加速需求,尤其在电池驱动设备中对于能效比提升的诉求是非常显著的,公司新产品可为这类设备在低功耗的前提下提供超高能效比的 AI 算力基础,恰到好处解决了这样的痛点。根据第三方专业咨询机构预测,端侧 AI 市场正在快速增长,预计到 2028 年,基于中小型模型的端侧 AI 设备将达到 40 亿台,年复合增长率为 32%;到 2030 年,预计 75%的这类 AIoT 设备将采用高能效比的专用硬件。 Q3: 公司第一代三核架构的芯片产品,目前客户导入的进展如何? 答: 公司已正式发布最新一代基于 SRAM 的模数混合存内计算的端侧 AI 音频芯片,采用 CPU+DSP+NPU 三核异构架构,可在更低功耗下提供更高算力,同时兼具更低的延迟和增强的安全性,将在音频应用和端侧 AI 中发挥重要作用。产品共包括三个芯片系列:第一个系列是 ATS323X,面向低延迟高音质私有无线音频领域;第二个系列是 ATS286X,面向蓝牙 AI 音频领域;第三个系列是 ATS362X,面向端侧 AI 处理器领域。目前,ATS3231 已搭载于品牌客户无线麦克风产品中上市发售。ATS286X、ATS362X 客户产品导入持续推进中,将会陆续上市销售。 Q4: 如何展望今年新产品贡献营收的趋势,对于公司 ASP 拉动的影响? 答: 公司基于三核异构架构的芯片采用了更加先进的工艺制程和存内计算技术,相较公司现有产品可以在现有功耗水平下提供几十倍至上百倍的算力提升,而相较于市场上主流的 NPU 产品能效比可以提升至少三倍以上,相较于主流的 DSP 产品在功耗方面能降低接近 90%,因此在价格上相较公司上代产品也会有十分明显的提升,今年新产品将对营收以及 ASP 持续产生正向拉动的影响。 Q5: 公司对于收并购的方向和规划是什么? 答: 收并购是国内外上市公司实现增长的一个重要途径,近期相关政策的出台也体现出监管层对上市公司使用收并购工具的支持。公司会从标的资产的协同效应、市场规模以及增长前景等多个角度对潜在的标的资产进行
--	---

	评估筛选，后续如涉及相关重大事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。 Q6：三核架构除了对当前场景的应用，未来会拓展在哪些潜在的领域？ 答：在基于 SRAM 的模数混合存内计算技术路径下的端侧 AI 音频芯片平台具有非常广阔的应用前景，主要可以覆盖语音与音频、视觉识别以及健康类监测等相关应用场景，并且可实现端侧 AI 解决方案的快速落地。公司也将积极打造 AI 开发生态，借助公司完整工具链轻松实现算法的融合，帮助客户迅速地完成产品落地，助力 AIoT 产品 AI 化的不断演进。 Q7：接下来的一段时间内，研发投入的方向以及相关人员费用的规划是什么？ 答：技术研发是公司业绩增长的重要驱动力，公司很高兴看到技术研发投入与营收规模提升保持着正向循环，2024 年公司研发支出 2.15 亿元，占营收比例约 33%，公司主要取得了三个方面的研发成果，第一是基于 CIM 技术打造了炬芯第一代三核异构架构的芯片平台，第二是发布了 ANDT 开发工具链，可以助力客户模型的快速部署，打造端侧 AI 高效开发生态环境，第三是持续升级拓展无线连接技术，低延迟高音质各项指标达到了业界先进水平。接下来一段时间，公司的研发投入方向也将继续围绕低功耗大算力、开发生态和无线连接三个方向拥抱端侧 AI 海量的芯片需求。 Q8：公司存算技术后续的路线迭代是什么计划？ 答：在存内计算（CIM）技术迭代上，包括制程节点、关键性能指标等方面，公司都有清晰的路线规划，目前已着手第二代 CIM 技术的相关 IP 研发工作，目标是将 NPU 单核算力提升三倍至 300GOPS，并直接支持 Transformer 模型，将能效比提高至 7.8TOPS/W@INT8。 Q9：公司产品在端侧 AI 落地的场景以及后续对于端侧 AI 市场的规划？ 答：公司的端侧 AI 处理器芯片当前优先应用在音频市场，相应的场景包括人声分离、AI 智能降噪等，公司发挥自身的技术优势，可以为端侧产品提供低功耗下的 AI 算力。公司会持续打造低功耗的 AI 算力平台，将逐步拓展至音频之外的更多场景应用，比如运动健康方面的传感器数据 AI 处理应用等。
--	---

	Q10: 针对 AI 眼镜、智能手表等智能穿戴类芯片会有新的芯片产品推出么? 答: 目前公司相关研发工作正在稳步推进中, 新一代智能穿戴芯片将采用三核架构, 搭载存内计算技术, 将为下游客户提供更具竞争力的芯片平台与产品解决方案。
是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 06 月 10 日